

信頼性試験結果 Reliability Test Result	Package(Type)	SMT3	ローム株式会社 トランジスタ・ダイオード ユニット ROHM CO., LTD. Transistor/Diode Unit
	品名(Product)	Bipolar Transistor (Pb Free)	
作成日(Date)：2/Feb/2010			

1. 試験結果(TEST RESULT)				
試験項目 (TEST ITEM)	試験条件 (TEST CONDITION)	準拠規格 (STANDARD)	n[pcs] (Sample QTY.)	Pn[pcs] (NG QTY.)
はんだ耐熱性 Soldering heat resistance	260±5°C, 10秒, リフロー方式 2回	EIAJ ED-4701/300 Test Method 301	22	0
	260±5°C, 10sec., Reflow method 2times			
	260±5°C, 10秒, はんだ槽		22	0
	260±5°C, 10sec., Solder-bath			
はんだ付け性 Solderability	350±10°C, 3秒, 手付け		22	0
	350±10°C, 3sec., Hand soldering			
	245±5°C, 3秒, リフロー方式	-	22	0
はんだ付け性 Solderability	245±5°C, 3sec., Reflow method			
	245±5°C, 3秒, はんだ槽	EIAJ ED-4701/300 Test Method 303	22	0
	245±5°C, 3sec., Solder-bath			
温度サイクル Temperature cycle	-55±5°C←→150±5°C 200サイクル -55±5°C←→150±5°C 200cycles	EIAJ ED-4701/100 Test Method 105	22	0
高温高湿逆バイアス High temp. high humidity reverse bias	85±2°C, 85±5%RH, 規定のバイアス, 1000時間 85±2°C, 85±5%RH, specified bias, 1000hours	EIAJ ED-4701/100 Test Method 102	22	0
飽和蒸気加圧 PCT Pressure cooker test	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100時間 121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100hours	JESD22-A102C	22	0
高温逆バイアス High temperature reverse bias	Ta=Tstg max, 規定のバイアス, 1000時間 Ta=Tstg max., specified bias, 1000hours	EIAJ ED-4701/100 Test Method 101	22	0
高温保存 High temperature storage	Tstg max., 1000時間 Tstg max., 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 201	22	0
低温保存 Low temperature storage	Tstg min., 1000時間 Tstg min., 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 202	22	0
端子強度(引っ張り) Lead strength (lead pull)	製品固定状態で軸方向荷重2.5N, 10±1sec保持. Sample body fixed, pulling lead axis direction, 2.5N, 10±1sec.	EIAJ ED-4701/400 Test Method 401	22	0
負荷寿命 Load Life	25°C, Pc=Pc max. 1000時間 25°C, Pc=Pc max. 1000hours	-	22	0
熱衝撃 Thermal shock	0°C ~ 100°C, 100サイクル 0°C ~ 100°C, 100cycles	-	22	0
耐溶剤性 Permanence of marking	イソプロピルアルコール, 23±5°C, 5分 IPA, 23±5°C, 5min.	EIAJ ED-4701/500 Test Method 501	22	0

2. 測定項目及び故障判定基準(FAILURE CRITERIA)			
測定項目 (ITEM)	測定条件 (CONDITION)	故障判定基準 (CRITERIA)	
しゃ断電流：ICBO Cutoff current：ICBO	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within two times of the standard value.	
しゃ断電流：IEBO Cutoff current：IEBO	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within two times of the standard value.	
増幅率：hFE DC current gain：hFE	仕様書条件による Per specification	初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%	
外観 Physical	目視 Visual check	著しい変化のないこと No outstanding change in physical.	
はんだ付け性 Solderability	目視 Visual check	リフロー方式 Reflow method	不濡れ(ランクC)無きこと Non-wetting (rank C) unseen.
		はんだ槽 Solder-bath	電極部の95%以上がはんだで覆われていること More than 95% of the electrode must be covered with solder.

3. 判定結果(JUDGEMENT)
各試験項目とも不具合の発生は認められておりません。 No failure is observed from each test item.